

ダイヤモンドワイヤーソー (長さ1km)

素線径・粒度の組み合わせで、様々なワークの切断に対応が可能です。

■ 素線径・粒度ラインナップ



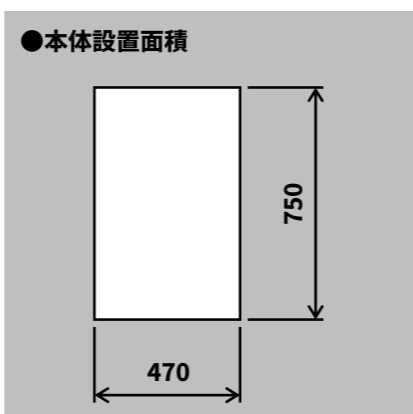
- ・素線径
 - ① 0.12mm
 - ② 0.16mm
 - ③ 0.25mm
- ・粒度
 - ① 10-20 μ m (面粗さ)
 - ② 30-40 μ m (標準)
 - ③ 40-60 μ m (切れ味)

素線径	0.12mm	0.16mm	0.25mm
耐久性	低い	↔	高い
カッティングロス	少ない	↔	多い
粒度	10-20 μ m	30-40 μ m	40-60 μ m
切断面粗さ	滑らか	↔	粗い
チッピング	小さい	↔	大きい

● 主な仕様

本機は、電着ダイヤモンドワイヤーを往復運動させて精密切断を行う卓上型ワイヤーソーです。低負荷切断に特化しており、セラミック材料のチッピング、金属材料のバリを抑えた切断が可能です。また、ワイヤーは一定の張力が働く機構を備えており、安定した切断を実現します。

電源	AC100V
切断方法	湿式/乾式
ワイヤー線速	5～300m/min (無段変速)
素線径	0.12mm～ 粒度10-20 μ m～
巻付量	約23m
ワークサイズ	W75×L75×H50mm
テーブルサイズ	W150×L100mm
ストローク	Max.180mm
送り方式	スライドテーブルウエイト送り方式 (標準) スライドテーブル強制送り方式 (オプション)
安全機能	<ul style="list-style-type: none"> ・非常停止スイッチ ・防水安全カバー ・ワイヤー切れ検出センサー ・切断終了センサー
ワイヤー交換	自動巻取り機能付き
機体寸法	W470×L650×H560mm
本体質量	約65kg
設置面積	W470×L750mm
オプション	<ul style="list-style-type: none"> ・精密位置決め装置 ・ゴニオステージ ・イオンミリング用治具



クーラント装置 (オプション)

点滴装置”点滴くん”

チューブポンプによる冷却水の供給をピンポイントで行う装置です。



卓上型ワイヤーソー シングルワイヤーソー

MW-400

軟質材料から硬質材料、脆性材料まで、乾式切断や貴重なサンプル、精密部品の加工も幅広く対応可能です。



● 製品動画



左記のQRコードを読み取って、製品の詳細動画をご覧ください。スマートフォンやタブレットで簡単にアクセスできます。

Let's **Make & Run Together**

<https://www.maruto.com/>
E-mail:maruto@maruto.com



本社 / 〒112-0003 東京都文京区春日 2-4-1
TEL: 東京 (03) 6801-0727 (代表) FAX: 東京 (03) 6801-2478
福岡連絡事務所 / 〒815-0033 福岡市南区大橋 1-21-5 岩田ビル
TEL: 福岡 (092) 512-2755 FAX: 福岡 (092) 561-4288



● 主な特長

防水安全カバー

切粉や冷却液の飛散を防ぎ、ワイヤー切れの際も安全です。

防水カバーリミットスイッチ

防水安全カバー開放時電動機動作不可。動作中に防水安全カバー開放で非常停止します。

タッチパネル

視覚的に操作しやすいタッチパネルを採用。デジタル制御による数値設定が可能です。



非常停止スイッチ

非常時に押すと機械が全停止します。

標準治具

75mm角のマウント台を固定する治具。左右方向に切断位置を微調整する事ができます。



ワイヤーの自動巻取り機能搭載

ダイヤモンドワイヤーをキャプスタンに自動巻取り可能です。

ワイヤー切れ検出センサー

加工中にワイヤーが切れた場合、機械は自動的に停止します。

切断終了センサー

試料の切りすぎや治具を切るなどを防止、任意の位置で設定可能です。

送り方式

スライドテーブルウエイト送り方式 (標準)

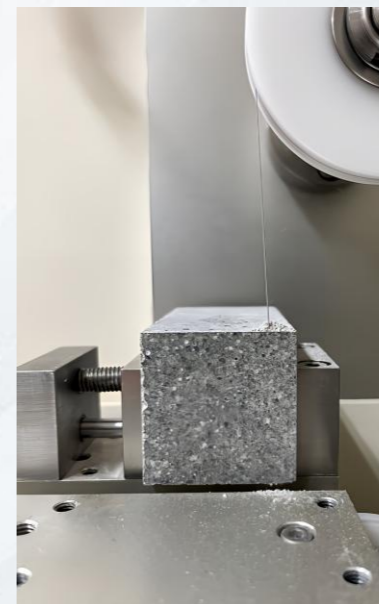
定圧切込みで複合材や切断面積が変わるものなど、切断抵抗が変化する試料などに適しています。

乾式切断に対応、なめらかな切断面が得られます

■ 切断事例

モルタル (W160×L40×H40mm)

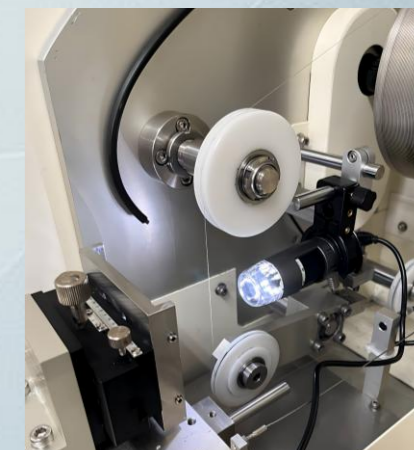
- ～切断条件～
- ・素線径 : 0.12mm
 - ・粒度 : 40-60 μ m
 - ・ウエイト : 300g
 - ・加工時間 : 60分



微小部品の切断及び正確な位置決めが可能

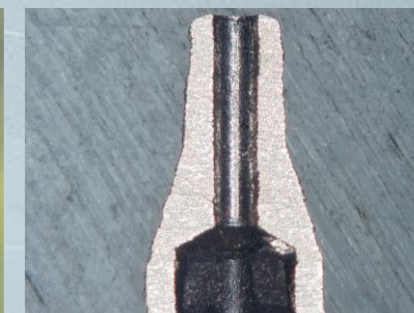
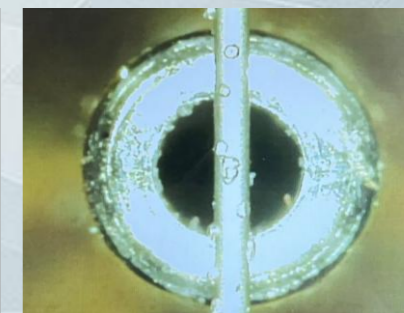
カメラ・モニターセット (オプション)

マイクロスコープカメラとモニターディスプレイを搭載する事により、微小部品の切断及び正確な位置決めが可能です。



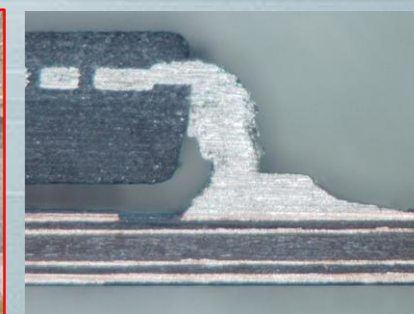
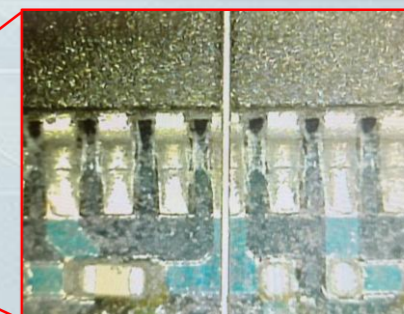
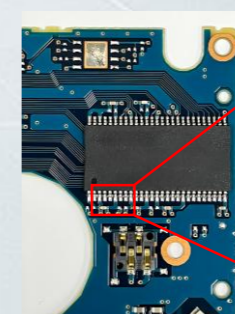
シャープペンシル先端部品の切断

- ～切断条件～
- ・素線径 : 0.12mm
 - ・粒度 : 40-60 μ m
 - ・ウエイト : 200g
 - ・加工時間 : 5分



電子基板部品の切断

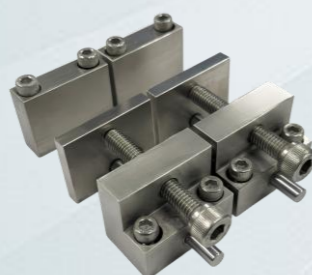
- ～切断条件～
- ・素線径 : 0.12mm
 - ・粒度 : 40-60 μ m
 - ・ウエイト : 200g
 - ・加工時間 : 5分



多彩なオプションをラインナップ

① 両押えバイス

試料を両側クランプする治具。欠けやすい試料や脆い試料の破損を低減します。



② ゴニオステージ

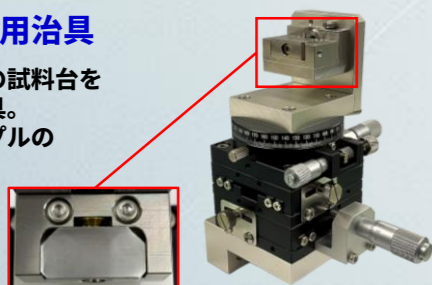
試料の傾斜 (θX軸・θY軸)、水平回転 (θ軸) 水平方向 (X軸・Y軸) 最大5軸を微調整可能な試料固定用治具です。

※写真は4軸ゴニオメーターになります。



③ イオンミリング用治具

イオンミリング装置用の試料台をそのまま装着できる治具。試料台に固定したサンプルのトリミングが可能です。



④ スライドテーブル強制送り方式

モーターによる定速送りで強制切込み、低負荷切断などに適しています。



※お客様の仕様に合わせて治具の設計・製作も承っております。